

はんだ・微細接合部会 シンポジウム

～微細はんだ接合部の部分はんだ付／実装技術最前線～

開催期日：平成21年6月26日（金）

開催場所：家の光会館 コンベンションホール（7階）（東京 飯田橋）

開催趣旨：日本溶接協会はんだ・微細接合部会が、新組織としてスタートしてから、早1年が経過致しました。「はんだ研究委員会」時代より様々な話題を提供させて頂きました主催シンポジウムも、その対象をはんだのみに限定せず微細接合にまで拡げて展開しております。今年度は、様々な分野で実用化され成長著しい「部分はんだ付」をクローズアップし、鉛フリー対応も含め最新研究技術動向を講演致します。また、新たな試みとして、エレクトロニクス実装学会電子実装技術委員会にも、ご協力いただき微細接合に関する最新実装技術をご講演頂くことになりました。未曾有の厳しい経済状況を打開する新たな製品・技術開発の一助となることを期待しております。皆様のご参加を心からお待ち申し上げます。

主 催：社団法人 日本溶接協会 はんだ・微細接合部会 技術委員会 微細接合技術分科会

共 催：社団法人 エレクトロニクス実装学会 電子部品実装技術委員会 先進実装技術研究会／電子部品技術研究会

後 援：社団法人 電子情報技術産業協会

【参加申込方法】

申込書（コピー可）に必要事項を記入し、下記申込先に郵送またはファックスでお送り下さい。受付後、折り返し参加証をファックスで送付いたしますので、シンポジウム当日は必ず参加証をお持ち下さい。

参加定員：定員180名（定員になり次第締め切ります。）

参加費用：（会員）12,000円、（非会員）18,000円／1名（資料代および消費税を含む）

※振込手数料は、各自ご負担下さい。

※会員とは、日本溶接協会 本部団体会員 (<http://www-it.jwes.or.jp/kain/kaindsp.jsp>) およびエレクトロニクス実装学会会員 (<http://www.e-jisso.jp/support/index.html>) です。

※日本溶接協会 はんだ・微細接合部会 部会員およびエレクトロニクス実装学会 電子部品・実装技術委員会委員の参加費用につきましては、別途各社委員へお問合せ下さい。

振込先：三井住友銀行 神田駅前支店 普通預金口座 No.146921（社）日本溶接協会

※参加費用は上記の口座にご送金下さい。また、納入された参加費は返却致しかねますのでご了承下さい。銀行口座への振込をもって領収にかえさせて頂きます。また、納入された参加費は返却いたしかねますのでご了承下さい。なお、参加費用の振り込みが、シンポジウム当日以後になる場合は、必ず申込書に振込予定日をご記入下さい。

お申込先：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-11 （社）日本溶接協会

担当：業務部 隅田 TEL：03-3257-1524 FAX：03-3255-5196

【プログラム内容】

午前の部： 座長 (株)村田製作所 高岡 英清 氏

10:00-10:05 開会挨拶 荘司郁夫氏 (日本溶接協会 はんだ・微細接合部会 微細接合技術分科会 主査)

10:05-10:40 「レーザーはんだ付技術のトレンドと今後の動向」
(株) ジャパンユニックス 若林 敏夫 氏

10:40-11:15 「レーザーはんだ付用やに入り糸はんだの開発動向」
千住金属工業 (株) 広瀬 慎悟 氏

11:15-11:50 「はんだごて規格標準化の動向」
白光 (株) 平井 惇 氏

11:50-13:00 昼食休憩

午後の部(パート1)： 座長 ソニー (株) 荒金 秀幸 氏

13:00-13:35 「フレキシブルプリント配線銅箔の電磁スポット溶接」
東京都立工業高等専門学校 相沢 友勝 氏

13:35-14:10 「半導体パッケージ用チップ接着材の信頼性に及ぼす影響について」
富士電機アドバンステクノロジー (株) 武井 信二 氏

14:10-14:45 「高精細・高信頼性の次世代液晶パネル実装技術とその応用展開」
セイコーエプソン(株) 橋元 伸晃 氏

14:45-15:00 休憩

午後の部(パート2)： 座長 実装技術 NPO 法人 サーキットネットワーク 本多 進 氏

15:00-15:35 「将来の宇宙用デバイステクノロジーと品質・信頼性確保」
日立化成工業(株) 長谷川 清 氏

15:35-16:10 「FPC 上における 0402 チップ部品実装技術」
フジクラ (株) 北田 智史 氏

16:10-16:45 「デジタル画像関連法による電子デバイスの熱変形計測」
(株)コベルコ科研 鈴木 康平 氏

16:45-16:50 閉会挨拶 土門 孝彰 氏 (エレクトロニクス実装学会 電子部品実装技術委員会 委員長)

シンポジウム企画担当者：日本溶接協会はんだ・微細接合部会微細接合技術分科会、エレクトロニクス
実装学会電子部品実装技術委員会先進実装技術研究会／電子部品技術研究会

